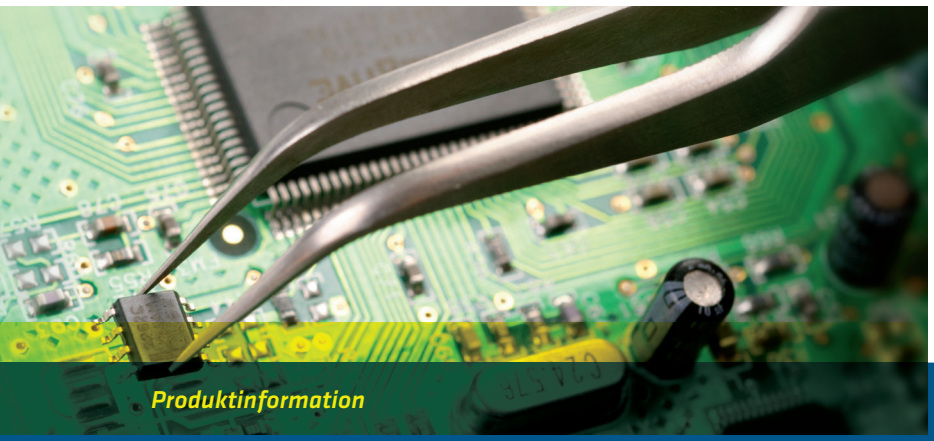


Produktinformation

TECASINT 5000 – Kostengünstige Polyimidtypen für die Halbleiterindustrie

TECASINT 5000 - Produktfamilie

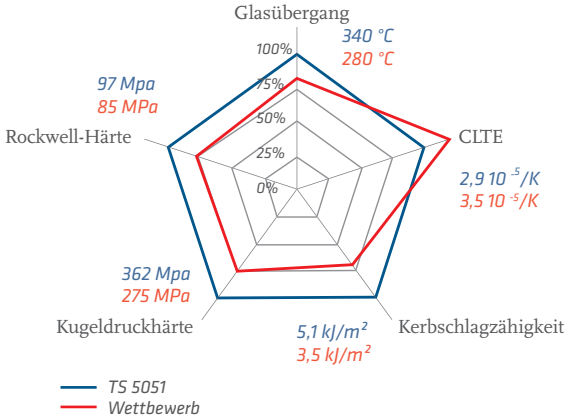
Die Produktreihe TECASINT 5000 umfasst nicht schmelzbare, amorphe Polyimide, die sich durch eine sehr gute Dimensionsstabilität und hohe thermische und mechanische Belastbarkeit auszeichnen. Bei kurzzeitiger Erwärmung auf 330 °C schmelzen und erweichen Teile aus TECASINT 5000 nicht.

Typische Eigenschaften

Technische Lösung für moderate Temperaturanforderungen bis 280 °C, mit höherer Glasübergangstemperatur als vergleichbare Wettbewerbstypen.

TECASINT 5000 bietet deutliche Vorteile gegenüber vergleichbaren gepressten Polyamidimid (PAI)- und Polyetherimid (PEI)-Typen.

→ Geringe Kriechneigung
→ Exzellente Dimensionsstabilität
→ Hohe Kugeldruck- und Rockwell-Härte
→ Sehr gute Verschleißfestigkeit
→ Hohe Lebensdauer



TECASINT 5111

Unverstärkte Type mit guten mechanischen Eigenschaften und verbesserter Zähigkeit und Zerspanbarkeit gegenüber der Vorgängertype. Elektrisch isolierend.

TECASINT 5051

Glasfaserverstärkte Type mit niedriger Wärmeausdehnung und guter thermischer Robustheit. Exzellente Verschleißfestigkeit und gute Dimensionsstabilität.

TECASINT 5501 – ESD Type

Elektrostatisch ableitende Polyimidtype mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 bis 10^8 Ohm. Niedrige Wärmeausdehnung und gute Dimensionsstabilität.

TECASINT 5511 – SD Type

Statisch dissipative Polyimidtype mit einem Oberflächenwiderstand von 10^9 bis 10^{11} Ohm. Niedrige Wärmeausdehnung und gute Dimensionsstabilität.

Sensorgehäuse TECASINT 5111:
Temperaturbeständigkeit bis 300 °C.
Sehr gute elektrische Isolation.

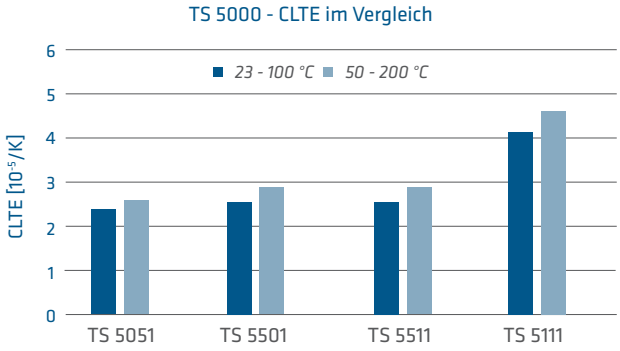
Anwendungen und Zielindustrien

Klassische Anwendungen sind in der Semicon- und Elektronikindustrie sowie im Maschinenbau, insbesondere in der Automation zu finden.

In der Semicon- und Elektronikindustrie kommen die Produkte der TECASINT 5000-Palette bei Kontaktierungen, Zuführungen und Testsockel für Mikrochiptestanlagen (Handler) zum Einsatz.

Diese Materialien werden vor allem in Handlingkomponenten und in der Produktion von elektronisch empfindlichen Bauteilen eingesetzt.

Wärmeausdehnung

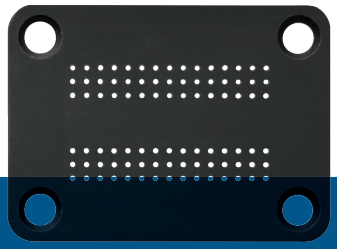


Zusammenfassung

Die Produkttypen der TECASINT 5000er Reihe bieten kosteneffiziente Anwendungslösungen bei hohen Temperaturanforderungen, die für viele thermoplastische Kunststoffe unerreichbar sind.

Bei noch höheren Anforderungen in Bezug auf Temperatur und Dimensionstabilität kommen unsere Produktfamilien TECASINT 2000 und TECASINT 4000 zum Einsatz.

Testsockel
TECASINT 5111:
Temperaturbeständig bis 300 °C.
Hohe Festigkeit.
Gute elektrische Isolation.



Lead Backer
TECASINT 5051:
Geringe Wärmeausdehnung.
Temperaturbeständig bis 300 °C.
Verschleißfest.

Kontakt

Ensinger Sintimid GmbH
Ensingerplatz 1
4863 Seewalchen
Österreich
Tel. +43 7662 88788 401
tecasint@ensingerplastics.com
tecasint.com

F-TS-5000-DE-V3-10/22